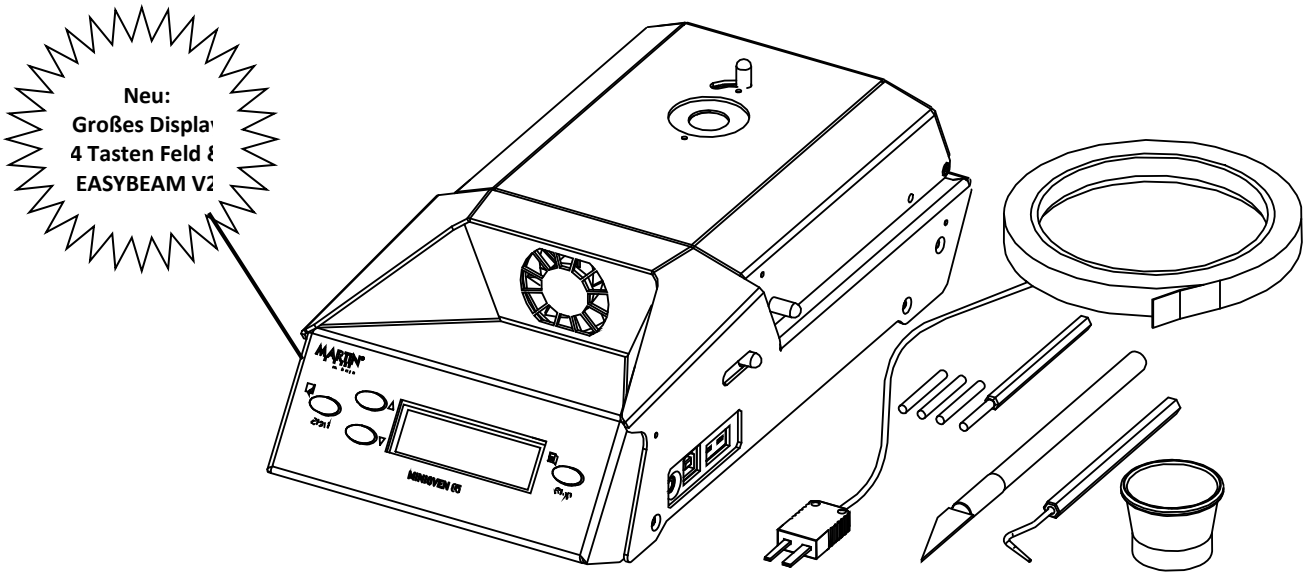
REWORK TECHNOLOGY

MARTIN®

a finetech company

MINIOVEN 05



HB00.0025 MINIOVEN 05

Der MINIOVEN ist ein kompaktes und robustes Tischgerät, das speziell für das Reballen von BGA Bausteinen und das Prebumpen von QFN Chips entwickelt worden ist. Einsatz findet das Gerät sowohl im Entwicklungsbereich als auch in der Produktion. Die effiziente Hybridheiztechnologie heizt elektronische Bausteine – wie im Reflowofen – von allen Seiten gleichmäßig auf und garantiert somit reproduzierbare Reballing-Ergebnisse.

Das große Display und die komfortable vier Tasten Menüführung erlauben das Anlegen und Verwalten von bis zu 25 Heizprofilen, die im Gerät abgespeichert werden können. Für möglichst hohe Zuverlässigkeit beim automatischen Lernen der Reballing Profile wird erstmals ein zusätzlicher, externer Temperatursensor benutzt. Mit seiner Hilfe werden die optimalen Profilparameter zum Erreichen der vorgegebenen Bauteiltemperatur ermittelt. Ein Anschluss für den Einsatz von Prozessgasen ist werksseitig vorbereitet. Somit können Reflow-Prozesse einfach umgestellt und z.B. unter Stickstoff Atmosphäre durchgeführt werden.

Die kostenfrei erhältlich PC-Software EASYBEAM V2 kommuniziert per USB mit dem MINIOVEN 05 und erlaubt es, Reballing Profile komfortabel zu editieren und die Temperaturentwicklung darzustellen. Zudem können über EASYBEAM V2 Profildaten auf die Festplatte gesichert und wieder ins Gerät zurückgeschrieben werden.

Neben dem Reballen von BGA Bausteinen sind Bauteilaufnahmen und Vorrichtungen für das Vorbeloten von QFN Bausteinen verfügbar. Eine umfangreiche Auswahl an Masken ist lagernd abrufbar.

Standardausstattung

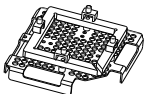
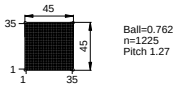
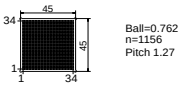
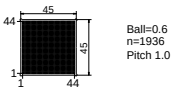
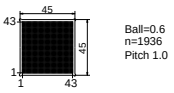
- MINIOVEN 05 Basisgerät
- Temperatursensor Typ-K
- Messer
- SMD Haken
- Reinigungsstift mit drei extra Einsätzen
- Rolle Kapton Klebeband
- Lupe
- Netzkabel
- Betriebsanleitung

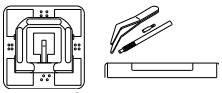
Technische Daten

Gesamtleistungsaufnahme:	550 VA
Leistung Unterheizung:	500 W, 4 x IR-Lampen
Größe Unterheizung:	105 x 130 mm²
Anzahl Sensoren:	1x intern fest verbaut + 1x extern frei
Anzahl an Profilspeicherplätzen:	25 Speicherplätze
Empf. max. Bauteilgröße:	55 x 55 x 4 mm³
Elektrischer Anschluss:	1 Phase, 230 VAC
Systemabmessungen:	150 x 300 x 85 mm³

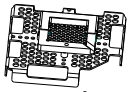
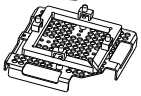
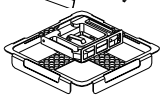
MINIOVEN 05

Anwendungssets

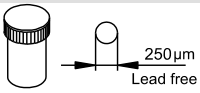
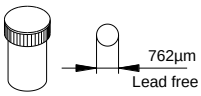
LW50.9001	**Reball-04 Set eco Standard**		**1 Set**
LW40.0236	Reballing-Halter BGA 45*45mm für MO-04/05 mit 4 Niederhaltern		Teil des Sets
LW40.0500	Reballing-Rahmen-Set BGA für alle (98%) BGA-Typen, 7 Stück		Teil des Sets
LW40.0543	Reballing-Maske BGA 45*45mm n=1225 / Pitch=1,27 / Grid=35*35 / Ball=0,762		Teil des Sets
LW40.0686	Reballing-Maske BGA 45*45mm n=1156 / Pitch=1,27 / Grid=34*34 / Ball=0,762		Teil des Sets
LW40.0688	Reballing-Maske BGA 45*45mm n=1936 / Pitch=1,00 / Grid=44*44 / Ball=0,6		Teil des Sets
LW40.0687	Reballing-Maske BGA 45*45mm n=1849 / Pitch=1,00 / Grid=43*43 / Ball=0,6		Teil des Sets

SF29.0002	**Prebump-04 Set QFN**		**1 Set**
HB50.0005	Grundausstattung Prebumping Set QFN Printer, Rakel, Halter, Pinzette		Teil des Sets
LWxx.xx11	Prebumping-Maske + Rahmen QFN Standardmaske nach Wahl		Teil des Sets

Zubehör

HB00.0112	Switch-Box Prozess-Gas für MINIOVEN 05 mit Anschluss-Set	
HB00.4005	Prozessgas Anschluss-Set für MINIOVEN 05	
LW40.0251	Reballing-Halter CSP 27*27mm für MO-04/05 Standard	
LW40.0236	Reballing-Halter BGA 45*45mm für MO-04/05 mit 4 Niederhaltern	
LW40.0237	Reballing-Halter BGA 45*45mm für MO-04/05 mit 4 Niederhaltern+Gitter (geeignet für PS3)	
LW40.0252	Prebumping-Halter mit Printer QFN 27*27mm für MO 04/05	

Verbrauchsmaterial

VD90.5104	Lotkugeln, 50.000 Stk, bleifrei CSP Sn96,5Ag3Cu0,5 250µm (=3g)	
VD90.5101	Lotkugeln, 50.000 Stk., bleifrei BGA Sn96,5Ag3Cu0,5 762µm (=86g)	
HT00.0009	Flux Pen bleifrei 0405 C, no clean, REL0	

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial unter www.martin-smt.de/Webshop